

2024年2月吉日

お客様 各位

RISE サンライズ 株式会社
工業用事業部

PHOTOBOND シリーズの価格改定について

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品を御愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社ではこれまでも度重なる原材料メーカーからの値上げ要求や、生産時の電気料金高騰を含めた加工費上昇の影響を受けておりましたが、経費削減や生産効率化などによってコスト吸収に努めて参りました。

しかしながら、これら外部環境の変動に対するコスト上昇を吸収することがこれ以上困難であるとの判断に至り、誠に申し訳ございませんが下記内容にて製品価格改定のお願いを申し入れさせて頂きたく存じます。

弊社といたしましては、今後も製品の安定供給、品質向上に努めて参りますので、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

対象： PHOTOBOND シリーズ

時期： 2024年4月1日出荷分より

改定内容： 15～20%の値上げを予定
(2024年3月に御見積書を配信予定)

以上